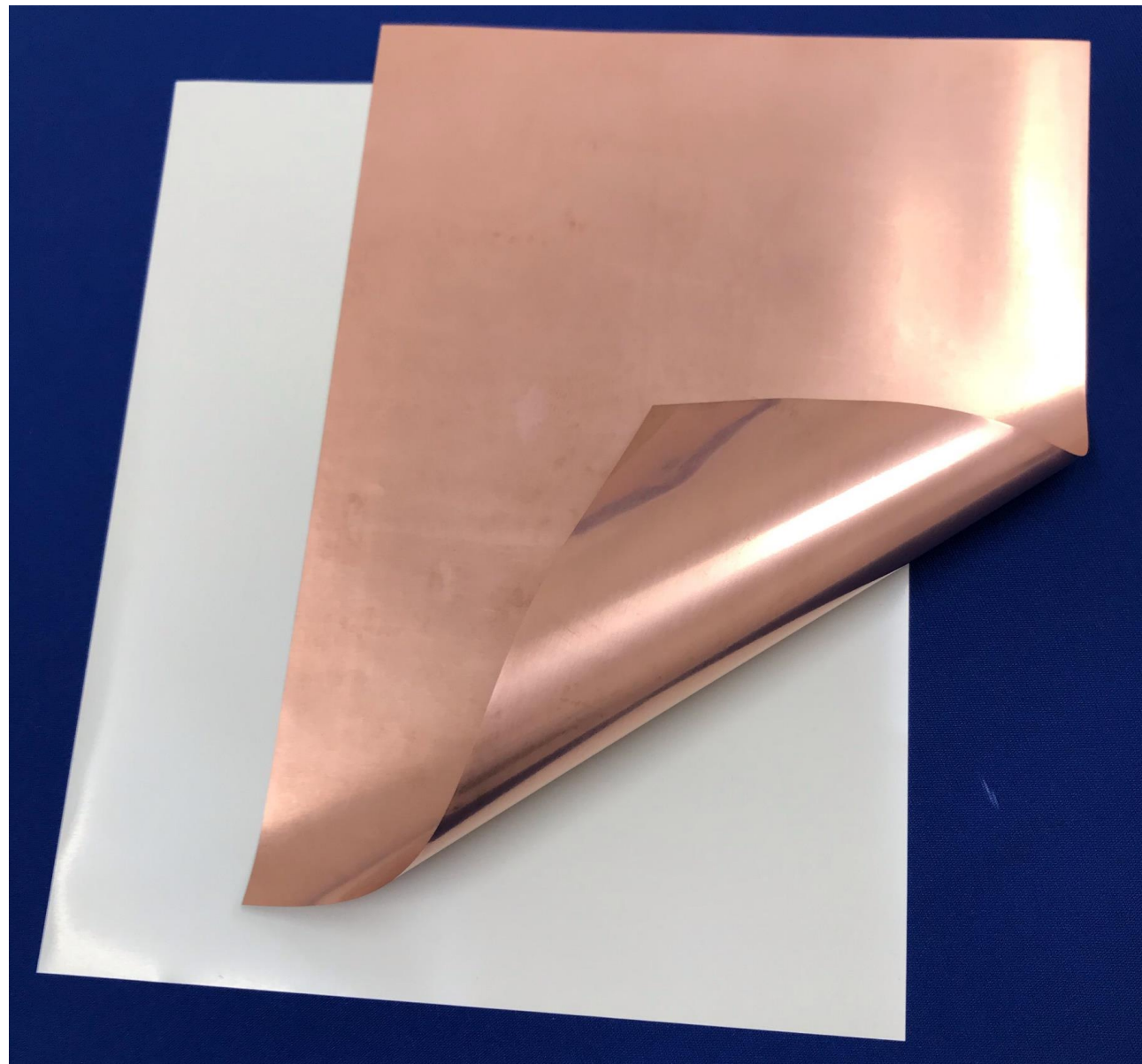


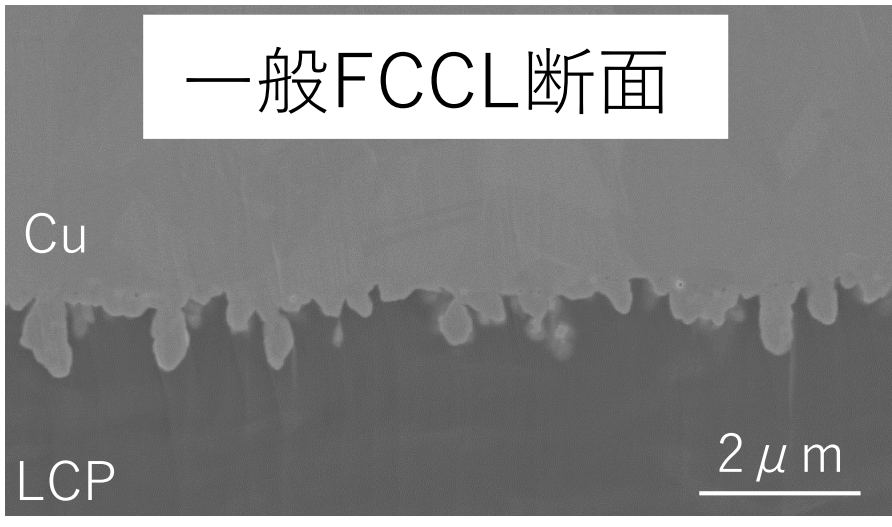
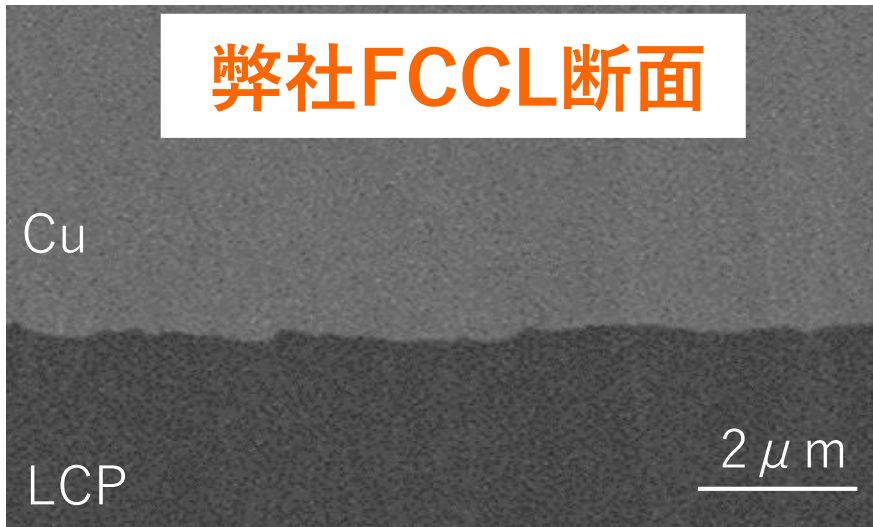
LCPベース フレキシブル銅張積層板

LCP上に極薄の銅層を形成したフレキシブル銅張積層板（FCCL）です
SAPによる微細配線加工が可能で高周波特性に優れる回路形成が可能です

特徴



- ✓ **極薄銅層を形成した銅張積層板です**
銅層厚み：0.1～0.3 μ m
LCP厚み：25, 50, 100 μ m
- ✓ **Cu/LCP界面が平滑なまま高密着を実現**
界面を荒らすことなく、銅層の高密着性を実現



開発品の代表的特性

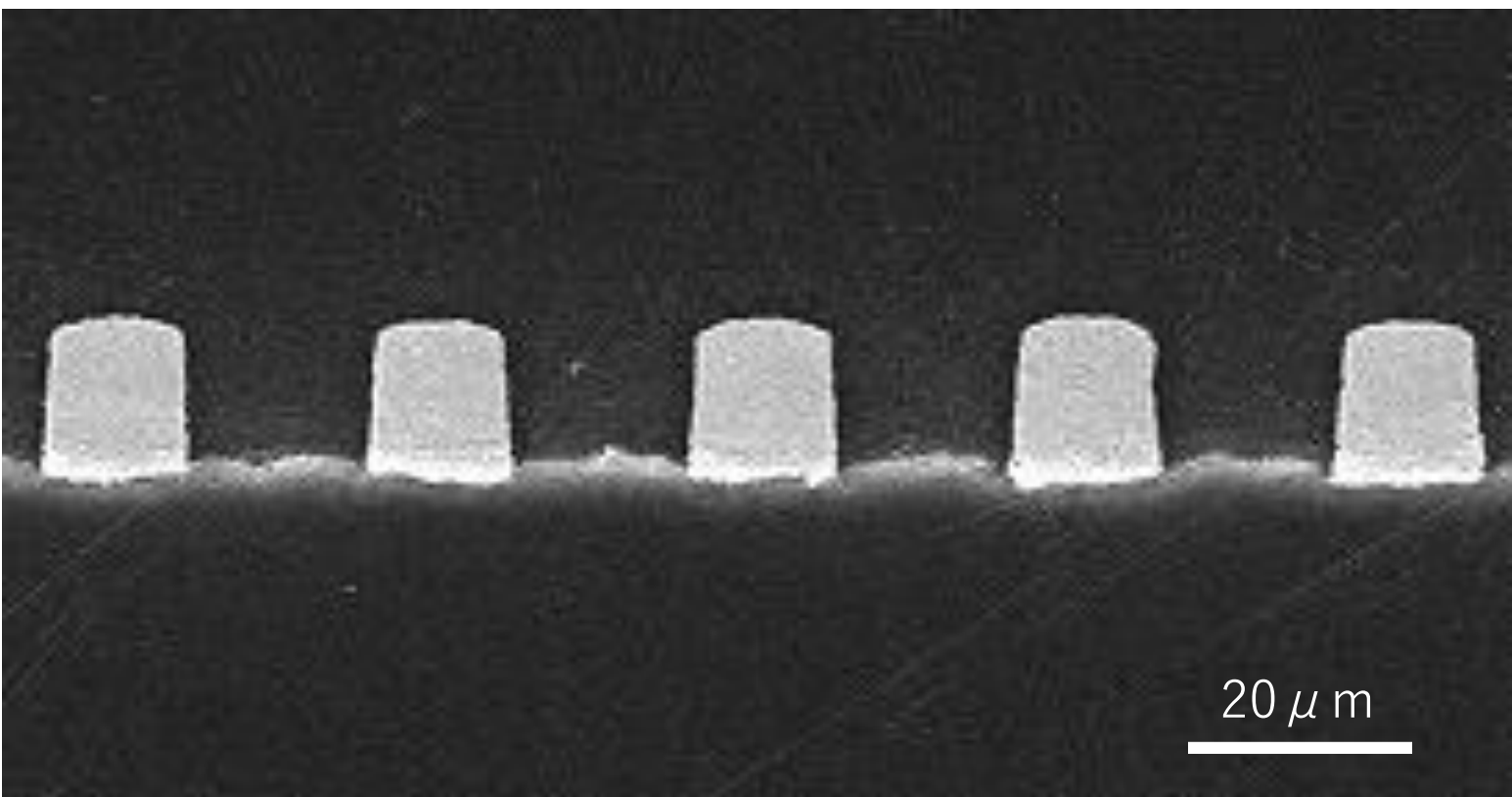
下記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません

項目	条件	無電解銅めっきFCCL
導体引き剥がし強さ	18 μ m厚めっき後室温下	0.7 N/mm
	18 μ m厚めっき後150℃×168時間後	0.7 N/mm
誘電正接	開放型共振ファブリペロー法28GHz	0.002
比誘電率		3.3
はんだ耐熱	260℃×5秒	異常なし

フレキシブル回路の微細化に貢献

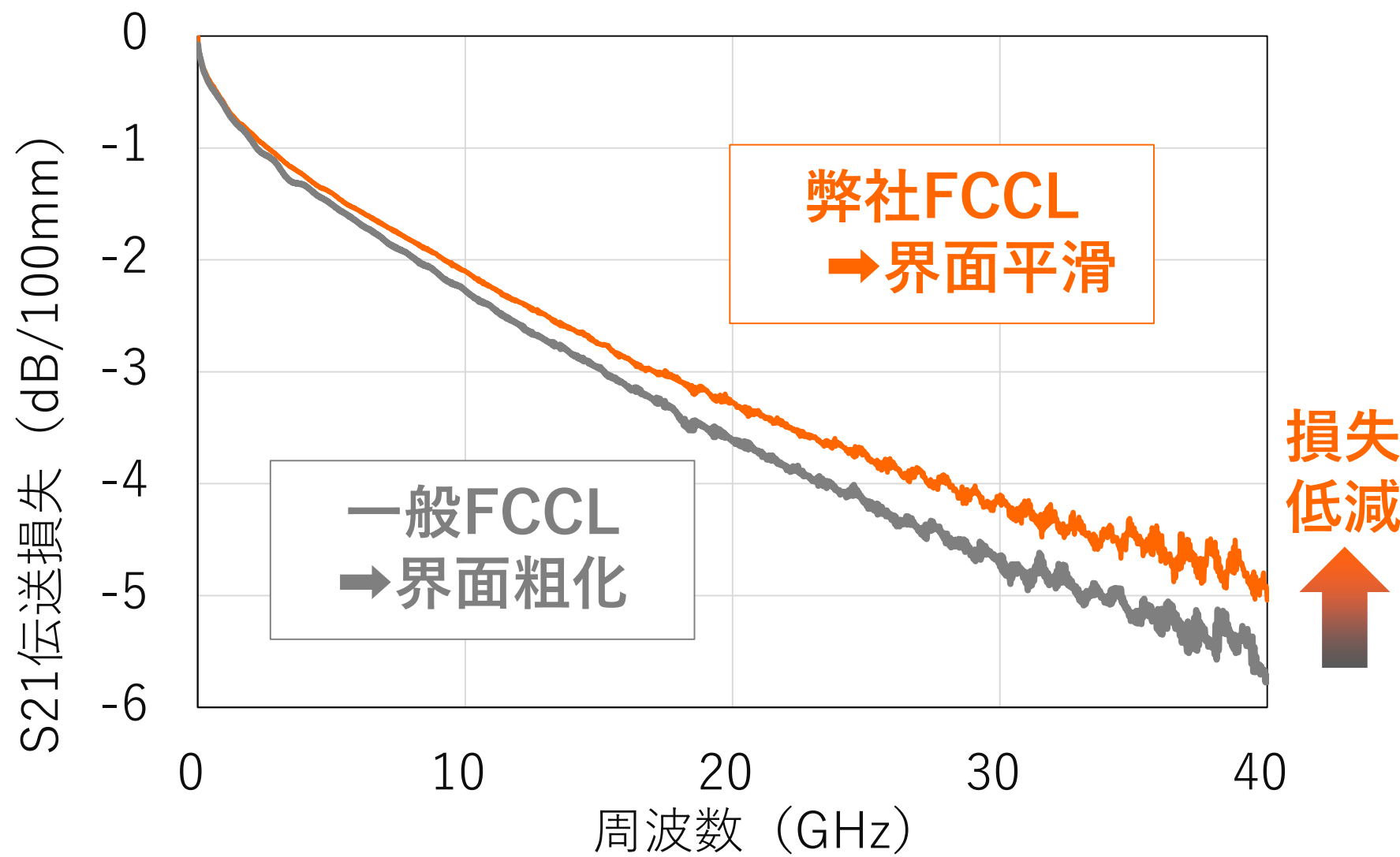
- ✓ **極薄 & 高密着な銅層により微細配線形成が可能です**

L/S=15/15 μ m配線の加工例（配線断面）



優れた伝送特性を実現

- ✓ **界面平滑により伝送損失の低減が可能です**



さらなる特性向上に向けた取り組み

- ✓ **LCP以外の低誘電樹脂ベース材も開発中です**

